

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

芯海科技（深圳）股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议	
日期/时间	2024年8月28日、29日	地点	会议室
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司怎么看 AI 技术为 PC 和手机等智能终端带来的增长机遇？</p> <p>公司回答：随着 AI 技术的发展，数据中心、AI PC、人形机器人等前沿应用领域的发展速度明显提升，计算“边缘化”趋势将更多 AI 和计算能力赋予边缘设备：在计算机外围产品生态中，公司基于自身深厚的技术积累，已实现了以 EC 为核心，覆盖 PD、HapticPad、USB HUB、BMS 的横向产品布局，同时，也完成了从 AI PC、笔记本电脑到台式机、工控机、边缘计算及服务器的 EC、SIO、edge BMC 的纵向产品布局；在人形机器人领域，感知、决策、执行等动作离不开对应的软件及硬件系统支持，面对 AI 技术发展趋势，公司拥有传感器信号调理、BMS、ADC 和压力触控芯片等产品可以用在相关领域，进行采集测量、信号处理和能耗管理。</p> <p>2、我们看到公司新发布了 edge BMC，请具体介绍一下这款产品？</p> <p>公司回答：AI 浪潮席卷全球势不可挡，智能边缘设备与 AI 技术逐步融合，公司推出的 edge BMC 是一套应用广泛的轻量化远程带外管理方案。过去，边缘设备在部署之后的长期维护是一个隐性难题，在偏远甚至恶劣的工况环境下，缺乏适应性的边缘设备往往频繁报错，导致高昂的运维成本负担。为此，公司 edge BMC 解决方案凭借其技术创新与卓越性能，在远程设备管理、运维成本降低等方面展现出显著优势，为各行各业提供了高效可靠的边缘计算解决方案。通过该方案，客户能够轻松实现</p>		

对边缘设备的远程监控、故障诊断和快速修复，从而大幅提升设备的管理效率，显著降低运维成本。

**3、公司二季度实现营业收入连续五个季度环比增长，请问业绩提升的主要原因？**

公司回答：公司 2024 年二季度实现营业收入 1.99 亿元，同比增长 106.79%，环比增长 31.37%。一方面，公司自上市后全力进行业务转型，从 2023 年开始，应用于通信与计算机、工业测量等新领域的新产品开始逐步放量，并在 2024 年开始大批量出货，2024 年上半年整体出货量同比增长 144%，其中：单节 BMS 上半年出货量已超过 2023 年全年出货量，增速迅猛，新品 2~5 节 BMS 也实现了大批量出货；应用于计算机及其周边的 EC、PD、HUB 系列芯片营收同比增长 136% 左右。随着消费电子需求复苏，行业库存见底，公司传统的 MCU 产品，健康测量及 AIOT 相关产品的销量也在稳步回升。未来公司将在 BMS、传感器调理、PC、汽车电子等重点战略方向上，坚持投入，不断提升自身行业地位，为长期持续发展提供增长动力。

**4、公司有什么产品可以应用于手机？**

公司回答：公司的压力触控芯片、触觉反馈芯片、PD 芯片、BMS 芯片等可以应用于手机上。

**5、公司在研发投入方面的规划？**

公司回答：经过前两年对高质量人员，特别是汽车电子、工业电子及质量管理团队的快速吸收，公司已经构建了较为完善的研发组织。未来公司将控制人员规模和费用规模的增长速度，将注意力放在提升公司管理效率，降低运营成本，提高公司利润水平上。

**6、公司 PC 业务今年预计给公司带来多少增量？**

公司回答：2024 年上半年，公司应用于计算机及其周边的 EC、PD、HUB 系列芯片营收同比增长 136% 左右。第一代 EC 芯片已经在计算机头部客户端实现大规模量产，第二代 EC 芯片顺利通过英特尔 PCL 认证，并通过计算机全球龙头企业验证。公司 EC 产品是大陆首个通过 Intel 国际认证的 EC 产品，打破了海外产品对于此市场的垄断，能够满足各种品类计算机的需求，目前已经完成和国内各个主流笔记本厂家的适配工作，例如已于报告期内发布的荣耀首款 AI PC MagicBook Pro 16 已于 3 月发布，该产品选择搭载了芯海科技高性能 EC 芯片。USB 3.0 产品已在客户端实现量产。针对边缘计算市场的轻量级 BMC 管理芯片，已完成开发和验证，即将上市。

	<p>应用于台式计算机的第一代 Super IO 产品开始导入客户端。未来，公司将继续加大在 PC 业务上的投入，致力于为客户打造更佳用户体验的产品。</p> <p><b>7、公司锂电管理类产品目前的销售或研发进展如何？</b></p> <p>公司回答：在锂电管理领域，应用于手机的单节 BMS 产品已经大规模量产，2024 年上半年出货量已经超过 2023 年全年出货量；应用于笔记本电脑、电动工具、无人机、扫地机器人等领域的 2-5 节 BMS 产品已经在头部客户端实现大批量出货；应用于新能源汽车及储能市场的多节 BMS AFE 芯片进展正常。</p>
附件清单 (如有)	/
以下本次活动参与人员签字页	
参与单位 名称	信达澳亚基金、山西证券自营、中信银行股份、兴证全球基金、深圳市新世界金融控股、百川资管、中信建投证券、中信证券
上市公司 接待人员 姓名	董事、副总经理、董事会秘书：万巍